



半導体用ウェットエッチング剤 フッ化水素酸 HF49%、HF50%

ウェットエッチング剤 フッ化水素酸(HF)は、半導体製造向けに金属イオンなどの不純物を大幅に低減した高品質なエッチング剤です。

1. 一般物性

項目	単位	数値
HF 濃度	mass %	(HF49%) 49 (HF50%) 50

【検査項目】

塩化物、硝酸塩、リン酸塩、アニオン系物質、カチオン系物質、微粒子

* 個別の品質につきましては、お問合せ下さい。

2. 取扱方法／安全情報

使用前に必ず SDS をお読み下さい。

該当法規に従い、包装、表示、輸送を行なって下さい。

3. 梱包仕様

5kg、25kg、100kg、1000kg

【連絡先】ダイキン工業株式会社 化学事業部

本社) 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目 4-12 梅田センタービル

東京) 〒108-0075 東京都港区港南二丁目 18-1 JR品川イーストビル

<http://www.daikin.co.jp/chm/>